

6-102692-5 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 6-102692-5

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 16 Position, 2.54 mm

[.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder,

AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 16

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 全部带罩     |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 否  |
| 位数       | 16 |
| 行数       | 2  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

|            |            |
|------------|------------|
| 端接电阻       | 12 mΩ      |
| 介质耐压 (最大值) | 750 VACrms |
| 工作电压       | 250 VAC    |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 端子接触部长度 | 5.08 mm[.2 in] |
|---------|----------------|



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in] |
|                | 100 – 200 μin   |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .762 μm[30 μin] |
| 端子形状和构造        | 正方形             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅              |
| 端子基材           | 磷青铜             |
| 端子接触部电镀材料      | 金               |
| 端子类型           | 插针              |
| 端子额定电流（最大值）    | 2 A             |

### 端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的  | 4.57 mm[.18 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

### 机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 接合对准类型     | 导针, 导针 |
| 接合固定       | 不带     |
| PCB 安装固定类型 | 板固定尾   |
| 连接器安装类型    | 板安装    |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装对准   | 不带     |
| PCB 安装固定   | 带有     |

### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

### 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 堆叠高度       | 11.43 mm[.45 in] |
| 连接器高度      | 13.97 mm[.55 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.4 mm[.055 in]  |
| 行间距        | 2.54 mm[.1 in]   |

### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用



焊接工艺特性

板支座

电路应用

Signal

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容

CSA LE7189, UL E28476

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装数量

68

封装方法

Tube

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

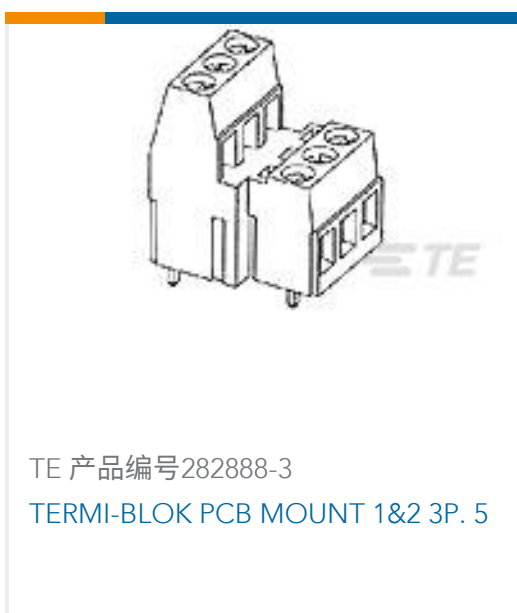
### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[16 MODII 2PC HDR DR SHRD, ROHS](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_6-102692-5\\_L2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_6-102692-5\\_L2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_6-102692-5\\_L2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5\\_CONT](#)

英文版本